

中国科学院上海微系统与信息技术研究所文件

科沪微所字〔2026〕138号

中国科学院上海微系统与信息技术研究所关于 印发《中国科学院上海微系统所公共技术中心 MEMS 工艺平台收费标准》的通知

机关各部门、各实验室：

《中国科学院上海微系统与信息技术研究所公共技术中心 MEMS 技术平台收费标准》已经 2026 年 8 月 31 日所务会讨论通过，现印发给你们，自印发之日起施行。原《中国科学院上海微系统所公共技术中心 MEMS 技术平台收费标准》（科沪微所字〔2023〕204 号）同时废止。

中国科学院上海微系统与信息技术研究所
2026 年 9 月 2 日

中国科学院上海微系统与信息技术研究所公共技术中心
MEMS 工艺平台收费标准

类别	设备名称	规格型号	项目	机时费			代工费	耗材费	备注
				所内	所外				
湿法清洗	高精度 TMAH 腐蚀系统	CSE14-WX-GJTMAH	硅腐蚀	150 元/240 分钟	180 元/240 分钟		200 元/批次	30 元/片/10 μm (*非硅材料腐蚀, 按照硅腐蚀常规速率和时间推算)	4/6/8
	高平整度化学机械抛光系统	Orbis	表面抛光	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/8
	有机物涂敷/清洗单元-湿法刻蚀机	MS8-2ET	金属单片腐蚀	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	有机物牺牲层去除单元-光刻板清洗机	MS200-MS	光刻板清洗	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	有机物牺牲层去除单元-剥离机	SS8-1IMIST	Liftoff	250 元/60 分钟	300 元/60 分钟		100 元/60 分钟	200 元/片	4/6/8
	多材料清洗腐蚀单元-RCA 清洗机	定制	炉前清洗	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	多材料清洗腐蚀单元-有机去胶清洗机	定制	清洗有机物	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		100 元/30 分钟	100 元/片	4/6/8
	多材料清洗腐蚀单元-KOH 后硫酸清洗机	定制	硫酸清洗/BOE	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	多材料清洗腐蚀单元-金属后清洗机-1	定制	金/铬腐蚀	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	多材料清洗腐蚀单元-金属后清洗机-2	定制	铝腐蚀/铝硅屑	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	多材料清洗腐蚀单元-金属前 BOE 清洗机	定制	氧化硅腐蚀/磷酸	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		100 元/30 分钟	磷酸 100 元/片	4/6/8
	清洗机 (KOH)	EH8	KOH 硅腐蚀	150 元/240 分钟	180 元/240 分钟		200 元/批次	15 元/片/10um	4/6/8
	氢氧化钾腐蚀机台	WM-46	KOH 硅腐蚀	100 元/240 分钟	120 元/240 分钟		200 元/批次	10 元/片/10um	4/6
光刻键合	等离子体激活机	np12	键合前处理	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	双兆声双面清洗机	CL8	键合前处理	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	MA6B 双面光刻机	MA6B	曝光	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6

	多衬底集成键合系统	MA/BA8	曝光	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	SB6e 键合机	SB6E	键合	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6
	高精度高压静电硅玻璃键合系统	EVG510/610	键合	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	EVG 光刻机	EVG620	键合对准	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6
	EVG 键合机	EVG510	键合	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6
	三维微结构大景深曝光系统	YL-D1000	激光直写	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	涂胶系统	RCD8	涂胶	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟	50 元/片	4/6/8
	柜式显影机	MS8-1D	显影	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	有机物涂敷/清洗模块-喷胶机	MS8-1SP	喷胶	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟	50 元/片	4/6/8
	有机物涂敷/清洗模块-匀胶机	SS8-2C2D	涂胶显影	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		100 元/30 分钟	50 元/片	4/6/8
	MEMS 晶圆双面对准与光刻系统	EVG6200NT	曝光	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
干法刻蚀	等离子灰化仪	Ion 40	射频等离子去胶	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	XeF2 气相腐蚀仪	e1	硅腐蚀	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6
	高精度深槽刻蚀机	LPX pegasus	深硅刻蚀	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	深反应离子刻蚀机	DSE200S	深硅刻蚀	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		6
	氢氟酸蒸汽腐蚀系统	MON3-A	氧化硅气相腐蚀	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	等离子纳米薄膜高精度刻蚀仪	RIE-101iph	介质层刻蚀	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	高精度深反应离子刻蚀设备	Pro ICP	深硅刻蚀	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	深反应离子刻蚀机 (STS)	M/PLEX ICP	深硅刻蚀	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	高垂直度深硅刻蚀机	NMC 508SVM	深硅刻蚀	900 元/30 分钟	1080 元/30 分钟		150 元/30 分钟		8
	金属反应离子刻蚀系统	SW GSE C200	介质/金层刻蚀	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		6
	微波等离子灰化系统	300 standart	微波去胶	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6
	等离子刻蚀机	Ionfab300 plus	离子束刻蚀	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	高精度高功率钻石电感耦合等离子反应离子刻蚀系统	RIE-800iP	介质层刻蚀	450 元/30 分钟	540 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	材料反应离子刻蚀单元-01	Winline-I200/C200	介质层刻蚀	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	材料反应离子刻蚀单元-02	Winline-I200/I200	介质层刻蚀	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	高深宽比刻蚀单元	Rapier	深硅刻蚀	600 元/30 分钟	720 元/30 分钟		150 元/30 分钟		8
	离子束刻蚀单元	Winline-IBE200	离子束刻蚀	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	离子束修调单元	UltraTrimmer™ Plus	材料表面修饰	2000 元/30 分钟	2400 元/30 分钟		150 元/30 分钟		8
	多材料有机物灰化单元	PACTO-10H/PACTO-16Q	微波去胶	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8

	多材料有机物灰化单元	PACTO-10H/PACT 0-10Q	微波去胶	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
薄膜沉积	磁控溅射系统	Discovery 635	磁控溅射	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟	8 元/nm(金)、5 元 /nm(铂)、50 元 /100nm (其他金属) *按炉结算	4/6/8
	电镀仪 (铜)	AIT-RP2	电镀	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		150 元/30 分钟	10 元/um(铜)	4/6/8
	PECVD 系统	Plasmalab system100	介质膜沉积	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	低应力等离子体增强介质沉积机 台	Taurus i200PES	介质膜沉积	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		200 元/30 分钟		4/6/8
	感应耦合等离子增强化学气相沉 积系统	SHL 200C-ICP	介质膜沉积	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	电子束纳米精确成膜制备系统	BC-1800C	蒸发薄膜沉积	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟		150 元/30 分钟	25 元/nm(金), 10 元 /10nm(其他金属) *按炉结算	4
	磁控溅射仪	MSP3300	磁控溅射	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟	50 元/100nm (铝等 普通金属) *按片结算	4
	磁控溅射设备	XM90	磁控溅射	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟	8 元/nm(金)、5 元 /nm(铂)、50 元 /100nm/片 (其他金 属) *按片结算	6
	磁控溅射仪	Discovery 24	磁控溅射	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		150 元/30 分钟	8 元/nm(金)、5 元 /nm(铂)、50 元 /100nm/片 (其他金 属) *按炉结算	4/6
	高深宽比纳米薄膜沉积系统	TF 200	原子层沉积	250 元/60 分钟	300 元/60 分钟		150 元/60 分钟	15 元/nm (氧化铝、 氧化锌)30 元/nm(氧 化钪) *按片结算	4/6/8
	电化学成膜系统	μ ALV-R&D+	电镀金属	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		150 元/30 分钟	1000 元/um(6 寸 金), 1600 元/um (8 寸金), 10 元	4/6/8

								/um(铜)；可镀面积占比<50%，按以上价格的 50%收取；	
	高厚度低阻抗金属材料制备单元	AM225P-PPP	AlN/AlScN/Mo 薄膜沉积	1000 元/30 分钟	1200 元/30 分钟		150 元/30 分钟	AlN 、 AlScN:2 元/nm, Mo: 50 元/100nm/片	8
	硅材料外延单元	Eris E120R	硅外延	750 元/30 分钟	900 元/30 分钟		150 元/30 分钟		8
	高厚度掩膜材料制备单元	EVA-601X	蒸发薄膜沉积	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟		150 元/30 分钟	40 元/nm (金), 35 元/nm(铂、钼), 20 元/10nm(其他金属)	4/6/8
	高致密度高粘附多层金属材料制备单元-1	DM-8CL	磁控溅射	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟	50 元/100nm (非贵金属) *按片结算	4/6/8
	高致密度高粘附多层金属材料制备单元-2	DM-8CL	磁控溅射	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟		150 元/30 分钟	8 元/nm(金)、5 元/nm(铂)、50 元/100nm/片 (其他金属) *按片结算	4/6/8
氧化扩散	RTP (快速退火炉)	Aw610	快速退火	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	快速退火炉	LRTP-1200	快速退火	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	低压化学气相沉积系统	DF550	LPCVD				500 元/300 分钟	3750 元≤0.5um, 超过 1500 元/100nm *按炉结算	4
	低压化学气相沉积系统	TS150-25W-4T	LPCVD				500 元/300 分钟	4250 元≤0.5um, 超过 1500 元/100nm *按炉结算	6
	离子注入	NV-6200AV	B/P 离子注入	650 元/30 分钟	780 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	氧化扩散系统	HORIS06481	热氧化	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		50 元/30 分钟		6
	金属合金炉	湖南艾克威	合金	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	mini 退火炉	自制	合金	25 元/30 分钟	30 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	高质量氧化介质薄膜制备单元	HORIC D200	热氧化	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		50 元/30 分钟		8
	高致密介质薄膜制备单元	TS200-50W-3T-SZ	LPCVD				500 元/300 分钟	4750 元≤0.5um, 超过 1500 元/100nm *按炉结算	8
工艺表征	材料快速热处理单元	RTP 810	快速退火	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	光谱椭偏仪	ME-SA	薄膜测量	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8

与辅助	半自动高温探针台	TS2000-SE	电性能探针测试	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	冷场发射扫描电镜	S-4800	SEM	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4
	离子溅射装置	E-1045	样品表面处理	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4
	白光干涉仪	ZYGO Zegage6301-031 0-01	形貌测量	200 元/30 分钟	240 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	探针式表面轮廓仪	Dektak XT	形貌测量	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	大量程硅薄膜厚度测量系统	F50-XT	硅薄膜测量	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	四探针	MODEL 120	方阻测量	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	膜厚仪（薄膜厚度测量系统）	1000-01293-REV B	薄膜厚度测量	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	探针式轮廓仪	Dektak XT	形貌测量	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
	三维红外显微镜	STM7	显微镜	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		100 元/30 分钟		4/6/8
	薄膜应力测试仪	FLX-2320-S	应力测试	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		150 元/30 分钟		4/6/8
后道封装	划片机	DAD3350	划片	250 元/30 分钟/ 350 元/30 分钟 (MPW)	300 元/30 分钟/ 420 元/30 分钟 (MPW)		/		
	芯片贴片机	HC-EB730	正装贴片	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		/		
	手动引线键合机	WB7476E	引线键合	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		/		
	自动引线键合机	ICONN	引线键合	150 元/30 分钟 (程 序设定费 300 元/ 个)	180 元/30 分钟 (程 序设定费 300 元/ 个)		/		
	材料局部高温处理单元	Amada SM-8500A	平行缝焊	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		/		
	氟油检漏平台	HF-3	气密性测试	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		/		
	拉力测试机	70-PTE	拉力测试	150 元/30 分钟	180 元/30 分钟		/		
	激光植球机	pactach	植球	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟		/		
	多功能倒装焊机	Fintech lambda1	倒装焊接	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟		/		
	真空回流焊机	HC-VS210H	共晶焊和回流焊	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		/		
	全自动点胶机器人	VS-300	自动点胶	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		/		
	等离子清洗机	GY-QX01	等离子清洗	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟		/		
	高低温快速温变试验箱	CTE-SE7503-05 F	快速温变试验	50 元/30 分钟	60 元/30 分钟		/		

MEMS 工艺平台常用材料领用收费标准

种类	规格	单价（元）
硅片	4 寸 N<100> 1-10Ω.cm 单抛 400-550um	250
	4 寸 N<100> 1-10Ω.cm 双抛 400-550um	400
	6 寸 N<100> 1-10Ω.cm 单抛 600-700um	250
	6 寸 N<100> 1-10Ω.cm 双抛 600-700um	450
	8 寸 N<100> 1-10Ω.cm 单抛 800-900um	400
	8 寸 N<100> 1-10Ω.cm 双抛 800-900um	500
氧化硅片	4 寸 N<100> 1-10Ω.cm 单抛 400-550um 2um 氧化硅	500
	4 寸 N<100> 1-10Ω.cm 双抛 400-550um 2um 氧化硅	650
	6 寸 N<100> 1-10Ω.cm 单抛 600-700um 2um 氧化硅	500
	6 寸 N<100> 1-10Ω.cm 双抛 600-700um 2um 氧化硅	700
	8 寸 N<100> 1-10Ω.cm 单抛 800-900um 2um 氧化硅	700
	8 寸 N<100> 1-10Ω.cm 双抛 800-900um 2um 氧化硅	800
玻璃	4 寸 500um 双抛 BF33	250
粘性芯片盒	小号（51*51mm）	25
	大号（85*85mm）	40
圆型单片盒	4 寸/塑料	25
	6 寸/塑料	50

注：

1. 平台如有新增设备尚未列入收费标准，收费参考本标准的同类设备。
2. 原则上收费标准每两年更新一次；
3. 贵金属定价每年更新一次；
4. 以上报价均未包含税费和管理费，外单位委托进行工艺、器件开发的，平台根据项目具体内容评估后报价。

